



TIGER KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH EPS/XPS

TIG 17

Produkt Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w aerozolu, do aplikacji przy pomocy pistoletu do pian, do mocowania płyt izolacyjnych EPS i XPS w systemach ociepleń ścian zewnętrznych oraz fundamentów i ścian piwnic

Właściwości

- formuła niskorozprężna – niski przyrost
- wysoka precyzja i kontrola nakładania
- bardzo dobra termoizolacyjność - $\lambda = 0,0348 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- wysoka stabilność wymiarowa i odporność mechaniczna
- niska wodochłonność
- kołkowanie płyt już po 2 h od aplikacji
- bardzo krótki czas przygotowania produktu do pracy w stosunku do tradycyjnych cementowych zapraw klejowych
- bardzo dobre właściwości robocze, komfort i czystość pracy, wygodny transport (niski ciężar i objętość towaru), niski koszt magazynowania
- brak ryzyka mostków termicznych na skutek dostania się kleju w szczeliny pomiędzy płytami (w przeciwieństwie do tradycyjnych cementowych zapraw klejowych)
- łatwość aplikacji (wystarczy pistolet do pian, nie potrzeba wiader, mieszalnika, szpachli, pac, dostępu do wody, prądu itp.)
- do styropianu tradycyjnego i szarego z dodatkiem grafitu, o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych
- po utwardzeniu chemicznie neutralny, odporny na szeroki zakres temperatur od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$ i rozwój grzybów oraz pleśni
- bardzo dobrze przyczepny do betonu, ceramiki budowlanej, silikatów, zapraw tynkarskich i murarskich, drewna, stali, metali
- nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

Zastosowania

- ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową (mocowanie płyt styropianowych EPS do podłoża betonowego)
- termoizolacja fundamentów, ścian piwnic i tym podobnych podziemnych części budynków (mocowanie płyt styropianowych EPS, styroduru XPS do podłoży mineralnych i bitumicznych)
- wypełnianie szczelin pomiędzy płytami izolacyjnymi, szczelin powstałych na skutek docinania płyt
- dylatacje pionowe w murach
- izolacja cieplna dachów i stropodachów
- uszczelnianie złączy, np. przy parapetach zewnętrznych, płytkach parapetowych, płytach balkonowych, oknach piwnicznych czy oknach w przyziemiu (dotyczy budowli nowo wznoszonych, jak i poddawanych renowacji)

Opakowanie 750 ml – blaszana butla

**Okres trwałości**

18 miesięcy od daty produkcji. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Temperatura w czasie transportu nie powinna spadać poniżej +5°C, chociaż ze względu na bezwładność temperaturową dopuszcza się kilkunastogodzinny przewóz w temperaturze ujemnej do -15°C.

DANE TECHNICZNE**Ciężar właściwy po utwardzeniu**

ok. 26 kg/m³ *

Baza

MDI

Wydajność

- do 8 m² (w przypadku klejenia płyt w systemie ETICS) *

- do 12 m² (w przypadku klejenia płyt przy ocieplaniu podziemnych części budynków) *

Czas otwarty (od nałożenia kleju do przymocowania płyt do podłoża)

ok. 4 minuty *

Czas całkowitego utwardzenia

do 24 h (pełna obciążalność mechaniczna) *

Odporność termiczna po utwardzeniu

od -40°C do +90°C (krótkookresowo do +140°C)

Przyrost wysokości piany (stopień ekspansji)

≤ 1,0 mm wg EOTA TR046

Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu

≥ 450 kPa wg EOTA TR046

Wytrzymałość na ścinanie

≥ 45 kPa wg EOTA TR046

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni (połączenie EPS/beton)

≥ 0,08 MPa wg EOTA TR046

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni (połączenie XPS/beton)

≥ 0,08 MPa wg EOTA TR046

Stabilność wymiarowa

- 5% *

Termoizolacyjność

λ = 0,0348 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogień

wg normy DIN 4102-1: B3

wg normy PN 13501-1: F

(*) – zależnie od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz podłoża, temperatury puszek, sposobu zastosowania, przekroju nałożonej warstwy, stopnia zwilżenia podłoża itp.

PODŁOŻA**Rodzaje powierzchni**

Większość spotykanych w budownictwie materiałów, w tym: beton, ceramika budowlana, silikaty, EPS, XPS, drewno i materiały drewnopochodne, stal, aluminium i inne metale, wybrane tworzywa sztuczne (twarde PCW, poliester, PU itp.), powłoki bitumiczne, papa, membrany bitumiczne.

Brak przyczepności do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), silikonu i PTFE.

W wypadku podłoży bitumicznych i tworzyw sztucznych zaleca się przeprowadzić test przyczepności.

Przygotowanie

Dla zwiększenia przyczepności, przyspieszenia utwardzania i poprawy struktury, podłoże można wstępnie zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza. Mocowane płyty powinny mieć proste krawędzie.

**Stan podłoża**

Powierzchnia do klejenia płyt musi być czysta, odpylona, płaska, wyrównana, bez zastoin wody. Nie może być oszroniona lub oblodzona. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ściany nie może przekraczać -4 mm i +2 mm. Pomiaru odchyień należy dokonywać łatą o długości 2 m, z dokładnością do 1 mm. W przypadku ścian charakteryzujących się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą (szpachlową).

SPOSÓB UŻYCIA**Temperatura puszeki**

od +5°C do +25°C (optymalnie +20°C)

Temperatura otoczenia i powierzchni

od +0°C do +35°C (optymalnie od +10°C do +25°C)

Zalecenia

Klejone powierzchnie muszą być nośne, czyste, suche, odtłuszczone. Fundamenty i ściany oczyścić z ziemi, glonów, mchów. Należy zwrócić szczególną uwagę, by na klejonych powierzchniach nie było szronu, zastoin wody. Świeże tynki i betony muszą być całkowicie związane i wysezonowane. Płyty izolacyjne formowane (inaczej niż cięte) mogą zawierać środki antyadhezyjne. Przeprowadzić test przyczepności kleju. W razie potrzeby przeszlifować tylną powierzchnię płyt. Powierzchnie bardzo gładkie, równe, nieprzepuszczalne (emaliowane, szklowane, glazurowane) zaleca się wstępnie zszorstkować, celem poprawy przyczepności kleju. Bezpośrednio przed użyciem puszkę z klejem bardzo dobrze wymieszać. Nakręcić na pistolet. Początkową partię kleju (ok. 30 cm), aż do wyrównania się ciśnienia w pistolecie, skierować na bok (klej nie do użycia). Przyklejanie płyt zaczynać zawsze od dołu, opierając dolny rząd płyt na listwie startowej lub stopie fundamentowej. Miejsca, w których klej jest wyeksponowany na działanie UV, należy zabezpieczyć w ciągu maks. 10 dni od nałożenia kleju. Do ochrony przed UV stosować zaprawy tynkarskie, szpachle lub elastyczne kity uszczelniające (silikon, akryl).

Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową

Klej nakładać na płyty po obwodzie z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi płyty oraz pasmem w kształcie litery „M” lub „W”. Pasma kleju powinny mieć szerokość ok. 3 cm. Grubość utworzonej spoiny powinna wynieść (po przyłożeniu płyty do podłoża) 8-15 mm. Powierzchnia klejenia nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni płyty. W ciągu maks. 5 min. od nałożenia kleju, przyłożyć płyty do podłoża i lekko docisnąć, używając łaty. Korektę równości ułożenia płyt przeprowadzić maks. do 20 min. od aplikacji kleju. Klej uzyskuje pełną wytrzymałość po 24 h od nałożenia. Podczas prac ściśle przestrzegać warunków stosowania określonych w projekcie technicznym ocieplenia, opracowanym dla określonego obiektu.

Termoizolacja fundamentów, ścian piwnic i tym podobnych podziemnych części budynków

Klej nakładać jednostronnie na podłoże pionowymi pasmami z zachowaniem 20-30 cm odstępów. Płyty przyłożyć do podłoża po maks. 5 min. od nałożenia kleju, a następnie równomiernie i mocno docisnąć. Powstałe złącza między płytami wypełnić także klejem.



Zalecenia	Prace na zewnątrz budynków powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie. Nie należy prowadzić prac przy dużym nasłonecznieniu i silnym wietrze. Nie stosować w miejscach pozbawionych dostępu powietrza, narażonych na ciągłe oddziaływanie wody i bezpośredni wpływ promieniowania UV (osłonić powierzchnię kleju). Podczas pracy z klejem zaleca się nosić odzież ochronną, rękawice i okulary. Nie stosować w pobliżu ognia.
Ograniczenia	- Do mocowania płyt w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków należy stosować dodatkowo kołki tworzywowe. - Stosowanie kleju powinno być zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonych obiektów. - Projekt powinien określać rodzaj i sposób przygotowania podłoża oraz rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych. - W termoizolacji podziemnych części budynków klej można stosować wyłącznie w systemach hydroizolacji lekkiej przeciwwilgociowej. - Nie stosować w przypadku ciągłej ekspozycji na wodę, np. zanurzenie spowodowane wysokim poziomem zwierciadła wód gruntowych (np. hydroizolacja ciężka przeciwwodna). - Nie stosować do PE, PP, teflonu, powierzchni silikonowych, pokrytych środkami poślizgowymi, nawilżającymi (np. membrany z filmem PE). - Nie stosować do podłoży hydroizolowanych za pomocą bitumicznych wyrobów rozpuszczalnikowych – ryzyko uszkodzenia płyt (zapoznać się dokładnie z instrukcją wyrobu i sprawdzić, czy producent przewiduje możliwość klejenia płyt styropianowych). - Płyty można kleić po całkowitym wyschnięciu powłok hydroizolacyjnych – zapoznać się z instrukcją wyrobu. - Zaleca się stosować do klejenia płyt o maksymalnych wymiarach 60 x 120 cm, niezależnie od grubości płyty i jej gęstości. - Czas utwardzania jest mocno uzależniony od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza.
Wykończenie	Po całkowitym utwardzeniu nadmiar kleju można odciąć. Utwardzony klej można tynkować, gipsować, malować.
Czyszczenie	Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Bostik. Resztki świeżego kleju można także usunąć przy pomocy czyścika Tiger Czyścik do piany lub acetonu. Uwaga, czyścik może wejść w reakcję z płytą izolacyjną i doprowadzić do jej uszkodzenia. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie lub stosując specjalny rozpuszczalnik Bostik do usuwania resztek utwardzonej piany.
Bezpieczeństwo ogólne	Patrz: Karta charakterystyki TIG 17 UWAGA: Chronić przed dziećmi.
Dokumentacja	Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0287 wydanie 3 Certyfikat zakładowej kontroli produkcji 020-UWB-0689/Z Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 37/00



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu, a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

8/04/2025